

第1回WBG実装コンソーシアム 「パワーモジュールの各種取組み状況」



2022年6月15日（水） リアル（阪大産研内I117室） + Zoom ハイブリッド開催

- 13:30～13:35 開会挨拶 大阪大学 F3D実装協働研究所 所長 菅沼 克昭
- 13:35～14:20 「産総研におけるSiCパワーエレクトロニクス実装技術の取組み」
産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター 佐藤 弘 氏
- 14:20～15:05 「SiCパワーデバイスの超高電圧機器への応用」
大阪大学大学院 工学研究科 & ネクスファイ・テクノロジー株式会社 中村孝 先生
- 15:05～15:15 ー休憩ー
- 15:15～16:00 「リカロイ™とその適用事例」
アルプスアルパイン株式会社 コンポーネント2事業担当 Lプロジェクト 仲野 陽 氏
- 16:00～16:45 「パワーモジュールのCu焼結接合」
Budatech GMBH Prof.Albrecht
- 16:45～17:00 「本コンソーシアムの課題と運営方法」 F3D(加藤)